

Singulation System

Model LSG 1040



**High-speed package dicing system
using laser technology**

高速レーザシンギュレーション装置

- さまざまな形状に対応したレーザダイサー
- 各製品に対して最適な切断プロセスの提案
- ツインレーザ・ツインテーブルにより、高速切断と高生産性を実現



SPECIFICATION

Items		Unit	Description						
モデル		—	LSG1040						
ワークサイズ	長さ	mm	230—300						
	幅	mm	62—100						
	厚み	mm	2 (Max.)						
パッケージサイズ	最小	mm	1×1						
	最大	mm	40×40						
基板反り量		—	2mm／300mm (Max.)						
レーザ		—	2 Heads, Twin tables						
外形寸法	モジュール	module	Cut Engine	Offload	Vacuum pump	Dust collector for laser	Dust collector for package collector (×2)	Chiller	
	幅	mm	2,325	1,500	1,000	900	627	445	
	奥行き	mm	1,935	1,760	900	850	588	400	
	高さ	mm	2,195	2,015	1,873	1,835	1,459	610	
重量		ton	5.7		0.8	0.34	0.14	0.04	
ワーク供給部	タイプ	—	スリットマガジン						
	数量	pcs	4 (Max.) マガジン幅115mmの場合						
製品収納部	タイプ	—	ビン						
	数量	pcs	4 (Max.)						
ピック&プレイスヘッド数		—	2units × 11pcs						
キット交換時間		min	20						
製品搬送方式		—	Vacuum						
製品処理能力		UPH	170,000						

・上記数値は当社標準機の場合です。
・改良のため仕様を変更する事があります。
・特殊システム仕様についてはご相談ください。



本社
〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国 TOWA (Shanghai) Co., Ltd. 台湾 TOWA Taiwan Co., Ltd. 韓国 TOWA Korea Co., Ltd. シンガポール TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd. マレーシア TOWA MALAYSIA SALES & SERVICES SDN. BHD. タイ TOWA THAI COMPANY LIMITED	フィリピン TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp. インド TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED ドイツ TOWA Europe GmbH オランダ TOWA Europe B.V. アメリカ TOWA USA Corporation
---	---